

LED5730圆形铝基板 PCB线路板 吸顶灯 齿轮型 江浙沪

产品名称	LED5730圆形铝基板 PCB线路板 吸顶灯 齿轮型 江浙沪
公司名称	连云港永合电子有限公司
价格	8.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:永合 型号:YH0011
公司地址	江苏 东海县 经济开发区晶都路898号
联系电话	86-051887280539 18112177399

产品详情

产品描述：

尺寸：直径25cm圆 铝基板厚度：0.9mm 铜箔：18 μ 5730 5630木林森焊盘

铝基板厚度：1.2mm 每片加1.5元。

yh0011型号：22w+18w+15w+10w+实心15w+4个3w

yh0027型号：18w+18w+15w+10w+实心12w+4个3w

yh0033型号：20w+18w+15w+10w+实心15w+4个3w

yh0040型号：18w+18w+15w+10w+实心18w+4个3w

yh0044型号：20w+18w+12w+12w+实心12w+4个2.5w

公司介绍：

连云港永合电子有限公司是一家专业生产pcb线路板的企业，以(高质量，低价格)为宗旨，自2013年开厂以来我们始终坚持以客户为第一、做最好品质、达最高效率、创最低成本、后工序一条龙配套服务，为您保证品质，降低成本，从而让贵公司的产品打入市场发挥更大的优势！ 诚然，您的宝贵意见或批评才是我们的真正资产,对您的任何意见或提议,我们均无任欢迎。我们希望在可见的将来，与您携手共进，共同开拓新的未来。

我司专业生产：

铝基线路板、玻纤板、纸板、cem-1、cem-3、94hb、94vo、fr-1，fr-4等单、双面线路板；

铜箔厚度：1/2-6盎司；

线路层数：1-2层；

最小线宽：0.1mm(4 mils)；

最小线距：0.1mm(4 mils)；

最小孔径：0.25mm(10 mils)；

板材厚度：0.8mm-3.0mm；

线路转移：曝光线路(湿膜、干膜)、丝印线路；

表面工艺：镀金、喷锡、沉金、松香、抗氧化等；

防焊油墨：感光、热、uv光固化油墨；

热风整平：单面及双面；

月生产能力：5000平方米

【产品描述】 >> 公司主要产品：大功率led铝基板、fr4线路板，长条形铝基板等单、双面铝基板。产品广泛适用于：((led照明 路灯照明、草坪灯、日光灯、矿灯.舞台灯.洗墙灯.电子、机械、通讯))等有高散热要求行业客户提供散热板。

1、表面工艺：喷锡、镀金、沉金 /松香、osp膜等。2、pcb层数layer
1-20层3、最大加工面积单面/双面板850x650mm single/4、板厚0.3mm-3.2mm 最小线宽0.10mm
最小线距0.10mm5、最小成品孔径e 0.2mm6、最小焊盘直径0.5mm7、金属化孔孔径公差 $0.8 \pm 0.05\text{mm}$
> $0.8 \pm 0.10\text{mm}$ 8、孔位差 $\pm 0.05\text{mm}$ 9、绝缘电阻 > 10¹⁴ (常态) 10、孔电阻 300 μ 11、抗电强度
1.6kv/mm12、抗剥强度1.5v/mm13、阻焊剂硬度 > 5h14、热冲击 288 10sec15、燃烧等级
94v-016、可焊性 235 3s在内湿润翘曲度 board twist < 0.01mm/mm 离子清洁度
< 1.56微克/cm²17、基材铜箔厚度：0.5oz 1oz 2oz 3oz18、镀层厚度：
一般为25微米，也可达到36微米19、常用基材：fr-4、fr-5、cem-1、cem-3、94vo、94hb fpc f4bm-220、客
供资料方式：gerber文件、powerpcb文件、protel文件、pads2005文件、autocad文件、orcad文件、菲林、
样板等

铝基板介绍：

特点目前，led应用的散热问题是led厂家最头痛的问题。散热基板是一种提供热传导的媒介，led 散热基板 散热模块，它可以增加led底部面积，增加散热面积，主要由铜箔电路/陶瓷粉末+高分子/铝基板组成。散热基板于led产业应用中具有高热率、安全性、环保性等功能。下面介绍采用铝材料的基板，因为铝的导热系数高，散热好，可以有效的将内部热量导出。铝基板是一种独特的金属基覆铜板，具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。

采用表面贴装技术（smt）； 在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理； 降低产品运行温度，提高产品功率密度和可靠性，延长产品使用寿命； 缩小产品体积，降低硬件及装配成本； 取代易碎的陶瓷基板，获得更好的机械耐久力。pcb铝基板的结构pcb铝基覆铜板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成，它的结构分三层：

circuit layer线路层：相当于普通pcb的覆铜板，线路铜箔厚度1oz至10oz。

dielectric layer绝缘层：绝缘层是一层低热阻导热绝缘材料。厚度为：0.003”至0.006”英寸是铝基覆铜板的核心技术所在，已获得UL认证。

base layer基层：是金属基板，一般是铝或可所选择铜。铝基覆铜板和传统的环氧玻璃布层压板等。

pcb铝基板由电路层、导热绝缘层和金属基层组成。电路层（即铜箔）通常经过蚀刻形成印刷电路，使组件的各个部件相互连接，一般情况下，电路层要求具有很大的载流能力，从而应使用较厚的铜箔，厚度一般35 μm~280 μm；导热绝缘层是pcb铝基板核心技术之所在，它一般是由特种陶瓷填充的特殊的聚合物构成，热阻小，粘弹性能优良，具有抗热老化的能力，能够承受机械及热应力。ims-h01、ims-h02和led-0601等高性能pcb铝基板的导热绝缘层正是使用了此种技术，使其具有极为优良的导热性能和高强度的电气绝缘性能；金属基层是铝基板的支撑构件，要求具有高导热性，一般是铝板，也可使用铜板（其中铜板能够提供更好的导热性），适合于钻孔、冲剪及切割等常规机械加工。

pcb材料相比有着其他材料不可比拟的优点。适合功率元件表面贴装smt工艺。无需散热器，体积大大缩小、散热效果极好，良好的绝缘性能和机械性能。

pcb材料相比有着其它材料不可比拟的优点。适合功率组件表面贴装smt工艺。

无需散热器，体积大大缩小、散热效果极好，良好的绝缘性能和机械性能。

导热系数导热系数又称为热传导系数，热传导率，热导率。它表示物质热传导性能的物理量，是当等温面垂直距离为1m,其温度差为1℃,由于热传导而在1h内穿过1m²面积的热量（千卡）。它的表示单位为：千瓦/米.小时。 [kw/(m.h.)]

如果需要基板材料担负更大的散热功效，所采用的基板材料要求是具有高导热系数（热传导率）。如果需要通过基板材料能够起到隔绝热的功效，那么就希望所用的基板材料的导热系数越低越好。

铝基板的热阻：定量描述一种物体的导热性能，可以用导热系数，也可以用另外一种特性参数来表达，它就是“热阻”。有关专著提出：导热系数适于表征一种均匀材质的材料的导热性能，而作为多种材料复合的基板材料，它的导热性能更适合于用热阻来定量描述。

在热传导的方式下，物体两侧的表面温度之差（简称温差）是热量传递的推动力。热阻（R_{rr}）等于这种

温差 (t_1-t_2)除以热流量 (p)。因此，基板材料的热阻越小说明它的导热性越高。

铝基板型号与参数现市场上根据需求一般铝基板可分为1.0mm，1.5mm和2.0mm三种厚度，基本参数为普通型和高导热型。普通型一般导热系数在1.0以上（铝基板基础导热率），高导型加了一层导热层，材料较贵，且工艺复杂，但导热性能优越，一般为1.5-2.0，也可根据需要定制（可达3.0以上）。另一重要参数为耐压，一般普通版为500v-2500v之间（视板材品质而定），优秀的板材可达3000v以上，也可定制（可达7000v以上）。

我们始终将"质量，诚信，服务"放在首位，相信我们创造性的劳动成果将时时吸引您睿智的目光，获得您的高度信赖，并为您的成功和发展做出贡献!

本产品的加工定制是是，品牌是永合，型号是YH0011，机械刚性是刚性，层数是单面，基材是铝，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是压延箔，增强材料是复合基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价，产品厚度是0.81.2，产品尺寸是250mm*250mm，额定功率是22W18W15W10W15W